

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒一对一沟通 ☒其他（电话会议）
---------------	--

	来看，伴随技术革新，先进制程存储芯片制造厂的刻蚀用量将增长，硅零部件的需求量将增大。 三、公司硅零部件产品的验证导入情况 公司硅零部件业务起步于2016年，是中国最早开拓该市场的本土企业。 公司所具备的“自产材料+零部件”的一体化研发生产能力，在中国本土厂商中独树一帜，产销量居于本土厂商前列，具备独特的技术优势和成本优势，拥有可持续的长期竞争力。 在过去数年中，公司硅零部件产品已经进入北方华创、中微公司等中国本土主流等离子刻蚀设备厂商，以及长江存储、长鑫存储、福建晋华、SK海力士（大连）等主流存储芯片制造厂，业绩连年增长，在中国芯片制造国产化中发挥了独特作用。 公司具备服务于中国全品类客户的技术研发和生产能力且持续扩产，但考虑到下游需求规模，产能仍相对不足，目前销售结构阶段性地以等离子刻蚀设备厂商为主。 四、公司硅零部件产品的本土需求来源 第一，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面不断赶超海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局，不断增长的产量和技术革新，需要更多、更高技术水平的硅零部件配套； 第二，中国芯片制造国产化进程进入“深水区”，供应链安全需求迫切，国产设备厂商技术水平不断提升并追赶世界先进水平，产品持续迭代升级，需要更多、更高技术水平的硅零部件配套； 第三，某些国家对跨国公司设立于中国大陆的存储芯片制造厂加以反复无常的技术钳制和产能限制，迫使后者将目光投向中国本土供应链，需要更多、更高技术水平的硅零部件配套。 综上，需求来源多样，市场机会窗口敞开，综合市场研究机构的公开数据和市场部的调研，公司认为当前中国本土市场的硅零部件需求约为60亿元人民币/年，未来五年的年化增长率不低于15%。
--	--

五、公司大直径硅材料的产能和定价情况

公司大直径硅材料产能曾经在上一轮周期景气高点达到满产状态。为此，公司于2023年进行了小额快速定增募资，用于大直径硅材料的新增产能建设。公司该产品的市场销售价格保持稳定。

当前，公司大直径硅材料产能居于全球前列，足以应对潜在增量需求，开工率提升空间较大，且具备在半导体周期景气时继续扩产的资金和技术能力。

六、存储市场变化与未来趋势研判

展望2025年第四季度以及2026年，公司认为当前半导体产业正在“换挡变速”：今年以来，全球科技巨头对算力中心的单季度资本开支金额，已经从此前的300亿至400亿美元，大幅增加到800亿至1000亿美元的历史新高，并叠加年底消费电子产业链备料出货需求，因此存储芯片产能出现结构性短缺；中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面不断赶超海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局；此外，消费者端侧应用创新正在加速，有望为半导体周期上行带来最根本且持久的市场驱动力。

公司大直径硅材料的制成品硅零部件，主要应用于存储芯片制造厂的刻蚀环节，开工率越高，使用量越大。公司认为，半导体产业周期上行有望带来更多市场需求。公司是上游材料及零部件供应商，如果下游终端存储芯片制造厂的开工率提升乃至资本开支增加带来新的需求，预计需要约1-2个季度传导到公司。

七、公司业绩的趋势性变化

分析2025年前三季度经营情况，公司管理层关注三个趋势：

第一，公司主力业务大直径硅材料的毛利率仍然保持在60个百分点以上，继续保持着领先的盈利能力，本季度公司的毛利率继续提升；

第二，公司成长型业务硅零部件占公司总营收的比重持续超过大直径硅材料，公司第二增长曲线进一步强化。公司已经从一家原材料公司逐步转变为一家长植根中国本土市场的“材料+零部件”公司；

第三，以上两项业务的融合，“自产材料+零部件”，带动公司自产大直径硅

	材料的用量，有望改变公司业绩“周期性”的特点，“成长性”将日益明显。 八、硅片业务的行业环境变化 公司注意到，半导体硅片产业在因时而变。 当前，全球半导体硅片市场低迷，只有与人工智能相关的需求相对景气，因此呈现出极端的结构性行情，乃至具备全球竞争优势和寡头垄断地位的日本厂商，从2025年第三季度开始陷入亏损。 因此，在8吋轻掺抛光硅片领域，日本厂商正在将更多产能调配至人工智能所需的12吋轻掺抛光硅片高端品类，以在不额外增加资本开支的前提下，改善其盈利能力。 考虑到中国本土8吋轻掺硅片的潜在市场需求仍然存在增长，日本厂商的动向有望扩大国产化空间。公司作为国内少数具备8吋轻掺抛光硅片技术和生产能力的企业，有望在行业供求关系的变动中，发挥自身独特技术优势，优化变动成本，改善竞争地位。 公司已从第三季度开始投入资源，针对下游评估的实际需求，小幅增加硅片生产量。公司将审时度势，严格控制该业务对公司整体业绩的影响。 九、硅零部件业务的扩产进度 土地、厂房、设备等生产要素的整備只是基础条件，“人机结合”更为关键，乃是一项系统工程。经过过去数年的连续扩产，该业务目前对公司的管理效率提出了更高要求乃至挑战。扩产的质量和扩产的速度需要保持最佳平衡，才能保障公司持续健康发展。 因此，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，努力保持良率及毛利率水平，继续保持以高端产品为主的销售结构，满足中国本土硅零部件国产化的需求。 前三季度，公司的硅零部件产能扩张方针“稳”字当头，产品结构改善，成本有所下降，毛利率稳中有升，取得良好成效。公司已从第三季度开始按计划增加产能，将继续参考过去几年的业绩增速曲线，合理配置资源，争取扩产质量和扩产速度之最佳平衡。
--	---

	十、公司未来计划 公司将稳健扩产并提升硅零部件产品收入；公司还计划抓住中国本土硅片市场供求关系的局部变化，满足下游客户的国产化需求；公司大直径硅材料产能全球领先，开工率提升空间较大，已经为新的外部需求做好准备，并为硅零部件业务的长远发展奠定坚实基础。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，提高了公司向金融机构申请授信的额度，从3.5亿元提高至8亿元。 综上，公司管理层已为接下来的潜在市场变化做好充分的产能和资金准备，将通过更高的资金使用效率来加强股东回报。 纵观国际半导体材料行业的发展历史，优质企业需要在做好内涵式发展的同时，通过外延式发展获得更快的成长加速度，公司亦不例外。公司将在不断夯实主业的大前提下，积极探索国内外行业内的协作机会，注重资产质量以及主业协同性，扎实稳妥地推进外延式发展，为股东带来更好的回报。
附件清单	无
日期	2025 年 11 月 27 日